

2026 年 1 月 30 日

研磨材事業における大分工場の能力増強投資について

富士紡ホールディングス株式会社（以下、当社）は、研磨材事業において、当社連結子会社であるフジボウ愛媛株式会社にて、新たな設備投資を実施いたします。詳細は、以下の通りです。

1. 能力増強投資の内容

（１）会社名	フジボウ愛媛株式会社
（２）増設設備の所在	大分工場 大分県大分市大字青崎 1 1 - 2
（３）投資総額	約 5 3 億円（注）
（４）投資内容	既存の大分工場内の敷地に、新たな建屋の建設並びに設備増設を実施。
（５）投資目的	研磨材製品であるソフトパッドの需要拡大が見込まれ、大分工場で一貫して製造できる体制整備と生産能力増強を実施する。
（６）稼働開始予定	2028 年度下期頃

（注）現時点で想定される数値であり、今後の詳細見積りに応じて変動する可能性あり。

2. 目的

当社の研磨材事業は、半導体デバイス（＊CMP）用途、シリコンウェハー用途、液晶ガラス用途、ハードディスク用途等により、業容を拡大しております。

＊CMP：Chemical Mechanical Polishing（化学的機械研磨）

CMP 用途については、AI 関連投資拡大、シリコンウェハー用途は半導体市場の拡大、ハードディスク用途はデータセンター需要拡大で、今後も堅調に推移することが見込まれます。

これらの需要増に対応するため、大分工場に後加工用の建屋・設備を新設して、同工場で一貫して製造できる体制を整備します。これにより、生産能力増強に加えて、主力の壬生川工場の BCP 機能も強化されます。

本件能力増強投資により、研磨材事業の更なる拡大を目指して参ります。

3. 今後の見通し

本件による当期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上